

2014-2020年中国半导体材料市场分析与行业调查报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国半导体材料市场分析与行业调查报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/S02716A266.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-09-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国半导体材料市场分析与行业调查报告》共十四章，报告旨在为投资者或企业管理者提供一个关于半导体材料产品的投资及其市场前景的深度分析，为投资者和企业管理人传递正确的投资经营理念和选择，提供一个中立、全面的投资指南手册，为半导体材料产品市场投资提供一个可供参照的标准。从而可以科学的帮助企业取得较高的收益。报告在全面系统分析半导体材料产品市场的基础上，按照专业的投资评估方法，站在第三方角度客观公正地对半导体材料产品的投资进行评价。为企业的投资决策提供了重要的依据。

2014及未来全球半导体业的态势会怎么样？答案肯定是好坏均占。

如ICInsight公司，认为2013年全球集成电路产业已度过最低增长的困难的5年周期，并开始新一轮周期的上升，这是一个好消息。在2007年至2013年期间，全球IC市场的年均增长率CAGR仅为2.1%。依ICInsight看，始于2013年的周期性复苏将推动未来持续若干年的增长，在2016年时可能达顶峰，增长达11%。所以在2013-2018期间IC市场的年均复合增长率预计在5.8%，为上一个周期的近三倍。在这段时间内，预计芯片出货量将以平均年增长6.3%和总IC的平均销售价格（ASP）预计将以年均1%的速度下降。

在今年的ISS会上有众多的演讲者，包括JonCasey（IBM）和MikeMayberry（英特尔）他们都表示，未来尺寸按比例缩小可小于10nm工艺节点，有可能延伸到7nm或5nm。然而，无论是演讲者和听众都提出同样的问题如果实现尺寸按比例的缩小需要付出什么样的代价

？RickWallace（KLA-Tencor）提醒我们，协和式超音速飞机的失败是经济问题，而不是技术。在绘制一张持续缩小的平行挑战图时，Wallace告诉我们摩尔定律更可能在董事会的会议室中死亡，而不是在实验室中。因此，我们真的需要倾听来自产品经理和管理人员以及一线技术人员的心声。

ISS会议明确指出，未来无所不在的计算是巨大推动力，将大大增加对于半导体市场的需求。然而，作为会议主要内容的物联网市场，必须在非常大量的应用前提下才能发展下去。最近的Tsensors峰会上也指出，无论半导体\MEMS或是Sensor出现爆炸性的增长只会发生在一个足够低的价格点上。

为什么呈不确定性？

从产品层面，尽管市场的推动力已由PC转向移动产品，包括智能手机、平板电脑等。但是它们的高潮已过，在发达国家中已呈饱和态势，而仅在发展中国家尚有一定余地，然而价格的竞争日趋激烈，逐渐向今天PC市场的低毛利率靠拢。从数量方面，2013年手机出货量18亿

台，同比增长3.3%，其中智能手机9.58亿台，同比增长39.9%。而2013年Tablet出货量1.79亿台同比增长50%。IDC等预测2014年全球手机出货量为18.9亿台，同比增长4.9%，其中智能手机12.44亿台，同比增长29.8%。而2014年Tablet出货量2.63亿台，同比增长46.7%。

市场盛传的iwatch等所谓穿戴式产品，尚需时日市场才能逐趋成熟。总的来说目前IC应用市场中并没有如手机、平板电脑等那样惊人的推动力。

从技术层面，近50年来，集成电路产品的性能改进和降低成本已成为半导体产业发展的基石。这些年来，半导体产业仍是继续缩小晶体管的尺寸，以及在每个工艺节点下仍保持每个逻辑门的成本每年有30%的下降。今天，业界关心的问题是：产业可以保持这样的趋势吗？答案肯定是并不简单。因为除了FinFET工艺及2.5D/3D封装等之外，两项关键性的技术，如EUV光刻与450mm硅片都存在相当程度的不确定性。

其中EUV的困难更大，因为至今由于光源功率等问题EUV光刻的硅片出货量不能满足量产目标，连G450C联盟认为需要在2016年时再次审查它。相对而言，450mm硅片，仅是整体进程方面有些迟缓，反映产业的紧迫感不够。至此G450C联盟的估计全球450mm准备生产在2017年底直到2020年年中的期间。实际上完全有可能提速，关键是那一家首先下了决心。Gartner的Bob Johnson认为，预计英特尔公司会在2018年中开始导入450mm硅片，以及TSMC可能在2019-2020年时成为第一个真正的450mm量产工厂。对于许多设备公司而言，它们担心的是投资回报率（ROI）尤其是全球非常有限的450mm设备的市场，但是目前似乎已木已成舟，设备公司已无路可退。

在产业急剧变化之中考验领袖们的智慧，每家公司的反应不尽相同。如由于NAND市场软弱的需求SanDisk的Manish Bhatia总结说，SanDisk/东芝公司不想建造最后一个300mm晶圆厂，也不准备建立全球第一个450mm晶圆厂。

未来会怎么样？

半导体业前进的步伐不会因定律终止而停步不前，非常可能是前进的步伐放慢。从2000年半导体销售额2000亿美元，直至2013年才跨进3000亿美元的关口。未来什么时间进入4000亿美元？引人思考。

之前产业每两年前进一个工艺节点，一路走来尚显顺畅，如今这样的利益点恐已成为过去，至少步伐已经放缓。所以未来产业的推动力引人关注。现在摆在产业面前的都是硬骨头，包括FinFET与FD-SOI工艺，2.5D与3D TSV封装，EUV光刻与450mm硅片等，每一项都十分艰巨，除了技术因素之外，更关切的是成本。套用业界一句流行口号需要持续的创新，但是谈何容易，尤其涉及到材料等基础的层面，需要十足的勇气与智慧。

然而，我们也不能气馁，要有足够的勇气与决心。因为总体上应用市场的前景仍非常大，未来无所不在的计算是巨大的市场推动力，仅是相比之前要付出更大的努力，包括如云计算

、物联网、汽车电子、节能及生命科学等。

全球半导体业存在不确定性，而中国的市场是全球化的，应该作那些准备呢？

报告目录：

第一部分 半导体材料行业发展概述

第一章 半导体材料产业基本概述

第一节 半导体材料的概述

一、半导体材料概念

二、半导体材料的分类

三、半导体材料的特点

四、化合物半导体材料介绍

第二节 半导体材料特性和制备

一、半导体材料特性和参数

二、半导体材料制备

第二章 2013-2013年半导体材料发展基本概述

第一节 主要半导体材料概况

一、半导体材料的特性和参数

二、半导体材料的种类

三、半导体材料的制备

第二节 其他半导体材料的概况

一、非晶半导体材料概况

二、GaN材料的特性与应用

三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章 2013-2013年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节 2013-2013年全球总体市场发展分析

一、全球半导体产业发生巨变

二、世界半导体产业进入整合期

三、全球半导体产业新进展

四、国际半导体市场增长减缓

第二节 2013-2013年主要国家或地区半导体材料行业发展分析

一、比利时半导体材料行业分析

二、德国半导体材料行业分析

三、日本半导体材料行业分析

四、韩国半导体材料行业分析

五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章2013-2013年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节2013-2013年中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、城乡居民家庭人均可支配收入

三、恩格尔系数

四、工业发展形势分析

五、存贷款利率变化

六、财政收支状况

第二节 2013-2013年中国半导体材料产业政策环境分析

一、《电子信息产业调整和振兴规划》

二、新政策对半导体材料业有积极作用

三、进出口政策分析

第三节 2013-2013年中国半导体材料产业社会环境分析

第五章2013-2013年中国半导体材料行业运行动态分析

第一节 2013-2013年中国半导体材料行业发展概述

一、全球代工将形成两强的新格局

二、应加强与中国本地制造商合作

三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节 2013-2013年半导体材料行业企业动态

一、元器件企业增势强劲

二、应用材料企业进军封装

三、新政策对半导体材料业的作用

第三节2013-2013年中国半导体材料发展存在问题分析

第六章 2013-2013年中国半导体材料行业技术分析

第一节 2013-2013年半导体材料行业技术现状分析

一、硅太阳能技术占主导

二、有机半导体TFT的应用

第二节 2013-2013年半导体材料行业技术动态分析

一、功率半导体技术动态

二、闪光驱动器技术动态

三、封装技术动态

四、太阳光电系统技术动态

第三节 2014-2020年半导体材料行业技术前景分析

一、高能效驱动方案前景分析

二、计算机芯片技术前景分析

三、太阳能产业技术前景分析

第七章 2013-2013年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节 2013-2013年中国第三代半导体材料相关介绍

一、第三代半导体材料的发展历程

二、第三代半导体材料得到推广

三、宽禁带半导体材料

第二节 2013-2013年中国氮化镓的发展概况

一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2013-2013年中国氮化镓的研发和应用状况

一、中科院研制成功氮化镓基激光器

二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化

三、非极性氮化镓材料的研究有进展

四、氮化镓的应用范围

五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 2013-2013年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料的发展
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓产业的发展应用状况
- 四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产

第二节 碳化硅

- 一、半导体材料碳化硅介绍
- 二、碳化硅材料的特性
- 三、高温碳化硅制造装置的组成
- 四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章 2010-2013年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

第一节 2010-2013年中国半导体分立器件制造业数据统计与监测分析

- 一、2010-2013年中国半导体分立器件制造业企业数量增长分析
- 二、2010-2013年中国半导体分立器件制造业从业人数调查分析
- 三、2010-2013年中国半导体分立器件制造业总销售收入分析
- 四、2010-2013年中国半导体分立器件制造业利润总额分析
- 五、2010-2013年中国半导体分立器件制造业投资资产增长性分析

第二节 2013年中国半导体分立器件制造业最新数据统计与监测分析（按季度更新）

- 一、企业数量与分布
- 二、销售收入
- 三、利润总额
- 四、从业人数

第三节 2013年中国半导体分立器件制造业投资状况监测（按季度更新）

- 一、业资产区域分布
- 二、主要省市投资增速对比

第十章 2013-2020年中国半导体市场运行态势分析

第一节 LED产业发展

- 一、国外LED产业发展情况分析
- 二、国内LED产业发展情况分析
- 三、LED产业所面临的问题分析
- 四、2014-2020年LED产业发展趋势及前景分析

第二节 集成电路

- 一、中国集成电路销售情况分析
- 二、集成电路及微电子组件（8542）进出口数据分析
- 三、集成电路产量统计分析
- 四、半导体集成电路产业发展趋势

第三节 电子元器件

- 一、电子元器件的发展特点分析
- 二、电子元件产量分析
- 三、电子元器件的消费趋势分析

第四节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场发展特点分析
- 二、半导体分立器件产量分析
- 三、半导体分立器件发展趋势分析

第五节 其他半导体市场

- 一、半导体气体与化学品产业发展概况
- 二、IC光罩市场发展概况
- 三、中国电源管理芯片市场概况

第二部分 半导体材料行业竞争分析

第十一章 2013-2013年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

第一节 2013-2013年国外年半导体材料行业竞争分析

- 一、2013-2013年欧洲半导体行业竞争机构分析
- 二、2013-2013年欧洲半导体产业竞争分析

第二节 2013-2013年我国半导体材料市场竞争分析

- 一、半导体照明应用市场竞争分析
- 二、单芯片市场竞争分析
- 三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节 2013-2013年我国半导体材料企业竞争分析

- 一、国内硅材料企业竞争分析
- 二、政企联动竞争分析

第十二章 2013-2013年中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 企业五

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 企业六

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 企业七

一、企业基本情况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 企业八

一、企业基本情况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 企业九

一、企业基本情况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 企业十

一、企业基本情况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节 企业十一

一、企业基本情况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第三部分 行业发展前景预测及投资分析

第十三章 2014-2020年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2014-2020年中国半导体材料行业市场趋势

一、2014-2020年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节 2014-2020年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2014-2020年中国半导体市场销售额预测分析

第四节 2014-2020年中国半导体产业预测分析

一、半导体电子设备产业发展预测分析

二、GPS芯片产量预测分析

三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十四章 2014-2020年中国半导体材料行业投资咨询分析

第一节 2014-2020年中国半导体材料行业投资环境分析

第二节 2014-2020年中国半导体材料行业投资机会分析

一、半导体材料投资潜力分析

二、半导体材料投资吸引力分析

第三节 2014-2020年中国半导体材料行业投资风险分析

一、市场竞争风险分析

二、政策风险分析

三、技术风险分析

第四节 博思数据专家建议

图表目录：（部分）

图表：元素半导体的性质与结构

图表：III-V 化合物半导体的性质

图表：II-VI 化合物半导体的性质

图表：部分 二元化合物半导体的性质

图表：CZT薄膜的能隙 E_g 与组分的关系

图表：2013-2013年第一季度全球前20名半导体公司排名情况

图表：2013-2013年全球各区域划分各季度对比情况

图表：2013-2013年IC产业产值情况

图表：钐锌矿Ga₂N和闪锌矿Ga₂N的特性

图表：双气流MOCVD生长Ga_N装置

图表：Ga_N基器件与CaAs及SiC器件的性能比较

图表：以发光效率为标志的LED发展历程

图表：非晶型氧化铟镓锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左)

图表：五种基本的印制方式

图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽

图表：软式微影技术的组件制作流程

图表：高分辨率软式微影技术压印头印制250nm×250nm方柱图

图表：由100μm玻璃背板及30μm聚合物双层模块成具有270nm图案之压印头实例

图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较

图表：主要半导体材料的对比分析

图表：半导体材料的主要用途分析

图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求情况

图表：多晶硅质量指标分析

图表：我国多晶硅产业的发展情况

图表：2004-2013年多晶硅价格走势情况

图表：GaAs单晶生产方法对比情况

图表：世界GaAs单晶主要生产厂家情况

图表：SiC器件的研究情况

图表：中国半导体材料需求量情况

图表：2013-2013年全球前20大半导体供应商情况

图表：2013-2013年各地区半导体增长估计情况

图表：1989-2013年全球半导体市场情况

图表：2013-2013年全球及中国半导体市场情况

图表：2013-2013年中国主要领域集成电路市场情况

图表：2001-2013年中国半导体工厂产能的预测对比情况

图表：2000-2013年中国晶圆与工厂产能利用率的预测情况

图表：全球fabless与半导体销售额情况

图表：2004-2013年全球代工市场销售对比情况

图表：2010-2013年半导体分立器件制造业企业数量增长趋势图

图表：2010-2013年中国半导体分立器件制造业亏损企业数量及亏损面情况变化图

图表：2010-2013年半导体分立器件制造业累计从业人数及增长情况对比图

图表：2005-2013年中国半导体分立器件制造业销售收入及增长趋势图

图表：2005-2013年中国半导体分立器件制造业毛利率变化趋势图

图表：2005-2013年中国半导体分立器件制造业利润总额及增长趋势图

图表：2010-2013年中国半导体分立器件制造业总资产利润率变化图

图表：2005-2013年中国半导体分立器件制造业总资产及增长趋势图

图表：2010-2013年中国半导体分立器件制造业亏损企业对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业不同规模企业分布结构图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业不同所有制企业比例分布图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业主营业务收入与上年同期对比表

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业收入前五位省市比例对比表

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业销售收入排名前五位省市对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业收入前五位省区占全国比例结构图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业主营入同比增速前五省市对比 单位：千元

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业主营业务收入增长速度前五位省市增长趋势图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业利润总额及与上年同期对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业利润总额前五位省市统计表 单位：千元

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业利润总额前五位省市对比图

图表：2013年中国半导体分立器件制造业利润总额增长幅度最快的省市统计表 单位：千元

图表：2013年中国半导体分立器件制造业利润总额增长最快省市变化趋势图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业从业人数与上年同期对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产总计及与上年同期对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产总计前五位省市统计表

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产总计前五省市资产情况对比图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产总计前五位省市分布结构图

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产增长幅度最快的省市统计表 单位：千元

图表：2013年1-12月中国半导体分立器件制造业资产增速前五省市资产总计及增长趋势

图表：LED照明在各种应用的渗透比例情况

图表：LED背光液晶电视多通道线性侧光方案分析

图表：LED背光模组与照明系统的分析

图表：2001-2013年中国集成电路及微电子组件进口量增长趋势图

图表：2001-2013年中国集成电路及微电子组件进口金额增长趋势图

图表：2001-2013年中国集成电路及微电子组件出口量增长趋势图

图表：2001-2013年中国集成电路及微电子组件出口金额增长趋势图

图表：2010-2013年集成电路及微电子组件进口来源地及量值统计表

图表：2010-2013年中国集成电路及微电子组件进口来源结构

图表：2010-2013年集成电路及微电子组件出口去向国家地区统计表

图表：2010-2013年中国集成电路及微电子组件出口去向分布图

图表：2010-2013年集成电路制造行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2013年集成电路产量全国统计

图表：2011-2013年集成电路产量北京市统计

图表：2011-2013年集成电路产量天津市统计

图表：2011-2013年集成电路产量河北省统计

图表：2011-2013年集成电路产量辽宁省统计

图表：2011-2013年集成电路产量上海市统计

图表：2011-2013年集成电路产量江苏省统计

图表：2011-2013年集成电路产量浙江省统计

图表：2011-2013年集成电路产量福建省统计

图表：2011-2013年集成电路产量山东省统计

图表：2011-2013年集成电路产量河南省统计

图表：2011-2013年集成电路产量湖北省统计

图表：2011-2013年集成电路产量广东省统计

图表：2011-2013年集成电路产量四川省统计

图表：2011-2013年集成电路产量贵州省统计

图表：2011-2013年集成电路产量甘肃省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量全国统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量北京市统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量天津市统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量河北省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量辽宁省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量吉林省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量黑龙江统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量上海市统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量江苏省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量浙江省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量安徽省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量福建省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量江西省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量山东省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量河南省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量湖北省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量湖南省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量广东省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量广西区统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量四川省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量贵州省统计

图表：2011-2013年半导体分立器件产量陕西省统计

图表：半导体气体与化学品技术发展蓝图

图表：2005—2013-2013年上半年中国电源管理芯片市场销售额规模及增长率情况

图表：2013-2013年上半年中电源管理芯片市场各应用领域增长率情况

图表：2013-2013年上半年中国电源管理芯片市场应用结构分析

图表：2013-2013年上半年中电源管理芯片路市场产品结构分析

图表：2000-2020年各类型太阳能电池市场占有率分析

图表：中国大陆及台湾地区薄膜太阳能领域部分厂商情况

图表：有研半导体材料股份有限公司200mm硅抛光片规格

图表：有研半导体材料股份有限公司150mm硅抛光片规格

图表：2011-2013年企业一主要经济指标走势

图表：2011-2013年企业一经营收入走势

图表：2011-2013年企业一盈利指标走势

图表：2011-2013年企业一负债情况

图表：2011-2013年企业一负债指标走势

图表：2011-2013年企业一运营能力指标走势

图表：2011-2013年企业一成长能力指标走势

图表：2011-2013年企业二主要经济指标走势

图表：2011-2013年企业二经营收入走势

图表：2011-2013年企业二盈利指标走势

图表：2011-2013年企业二负债情况

图表：2011-2013年企业二负债指标走势

图表：2011-2013年企业二运营能力指标走势

图表：2011-2013年企业二成长能力指标走势

图表：2011-2013年企业三主要经济指标走势

图表：2011-2013年企业三经营收入走势

图表：2011-2013年企业三盈利指标走势

图表：2011-2013年企业三负债情况

图表：2011-2013年企业三负债指标走势

图表：2011-2013年企业三运营能力指标走势

图表：2011-2013年企业三成长能力指标走势

图表：2011-2013年企业四主要经济指标走势

图表：2011-2013年企业四经营收入走势

图表：2011-2013年企业四盈利指标走势

图表：2011-2013年企业四负债情况

图表：2011-2013年企业四负债指标走势

图表：2011-2013年企业四运营能力指标走势

图表：2011-2013年企业四成长能力指标走势

图表：2010-2013年半导体行业设备投资额的年变化走势分析

图表：略……

本报告详述了半导体材料产品的行业概况、市场发展现状及半导体材料产品市场发展预测（未来五年市场供需及市场发展趋势），并且在研究半导体材料市场竞争、原材料、客户分析的基础上，对半导体材料行业投资前景及投资价值进行了研究，并提出了我们对半导体材料产品投资的建议。

本报告以定量研究为主，定量与定性研究相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息，采用统计图表等多种形式将研究结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度保证了报告内容的系统性和完整性，为企业的发展和对半导体材料的投资提供了决策依据。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/S02716A266.html>